

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术



**深圳科瑞技术股份有限公司**  
**2026年度向特定对象发行股票募集资金使用**  
**可行性分析报告**

**二〇二六年九月**

## 一、本次募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过 75,248.41 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                  | 项目总投资     | 拟投入募集资金   |
|----|-----------------------|-----------|-----------|
| 1  | 超高精密度零部件基地建设及相关设备扩产项目 | 69,729.39 | 63,248.41 |
| 2  | 补充流动资金                | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 合计 |                       | 81,729.39 | 75,248.41 |

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

## 二、投资项目基本情况

### （一）超高精密度零部件基地建设及相关设备扩产项目

#### 1、项目基本情况

本项目系公司顺应半导体设备国产化与光通信产业代际升级趋势，前瞻布局超高精密制造能力的重要举措，通过购置先进的生产设备、检测设备，在深圳扩建面向半导体及光通信等领域的精密零部件与精密设备生产基地，搭建面向半导体超高精度精密零部件与精密设备规模化生产装配的高标准厂房和净化车间。

本项目建成后，将形成精密零部件及规模化装配设备合计年产值 10.53 亿元的生产能力，强化设备与零部件协同配套能力，增强对国内外头部客户的批量订单交付能力。项目将依托公司平台型技术体系优势，深度对接头部客户研发导入与量产配套需求，助力公司深度参与半导体设备国产化进程、把握下一代光互联技术产业化机遇，提升公司在超高精密制造领域的核心竞争力与盈利能力。

## 2、项目实施的必要性

### （1）深化设备与零部件协同配套能力，把握下游产业迭代机遇

精密零部件下游应用高度分散，不同设备厂商对零部件的结构、材料与性能要求存在显著差异，行业整体呈现高度定制化的业务特征。随着光互联技术持续演进、半导体先进制程持续发展，下游对零部件精度、稳定性及交付一致性的要求持续提升，下游客户对可深度参与前端研发、同时具备设备与零部件协同配套能力的供应商需求日益增强。在此趋势下，仅有单一加工能力的企业难以满足客户对系统级解决方案的需求，设备与零部件的协同开发能力正逐步成为客户筛选供应商的核心标准。面对下游客户对一体化解决方案需求的持续升级，公司亟需进一步强化设备与零部件的协同配套能力，巩固在高端客户供应链体系中的重要地位。

本项目将强化公司在非标定制、协同配套及客户早期研发介入方面的综合服务能力。项目建成后，公司将进一步完善从核心零部件到精密设备的完整供应链条，更好把握光通信及半导体产业迭代带来的业务机会，深化与下游头部客户的战略合作关系，在客户下一代产品迭代周期中持续获得增量订单，夯实公司在精密制造领域的市场竞争优势。

### （2）布局超高精密制造能力，把握光通信产业及相关产业代际升级潜力

随着人工智能技术深度普及与规模化应用，全球高性能计算及高速数据传输领域需求呈现爆发式增长。AI 算力集群的大规模部署推动数据中心互联架构加速向超高速率方向迭代，光通信产品从 400G 向 800G、1.6T 乃至更高速率持续升级，传统可插拔光模块架构在高速率场景下面临信号衰减、功耗攀升等系统性瓶颈，共封装光学 CPO 技术已成为行业未来演进方向，配套的精密金属零部件及核心工艺设备需求随之迎来快速增长。行业技术迭代对配套零部件、核心设备的加工精度、稳定性、一致性提出了更高要求，超高精密零部件和设备成为行业产业化的核心关键。

公司在光通信领域已有产品布局与客户基础，产品涵盖主流高精密结构件，已在光模块核心工艺段获得海外头部客户验证与认可。同时，公司光器件耦合设备、光模块芯片共晶贴片设备等设备核心技术达到行业领先水平。面对光通信行业技术路线升级带来的增量市场空间，公司现有超高精密零部件与设备产能难以充分承接下游客户持续增长的采购需求。

本项目立足行业高端化发展趋势，聚焦光通信领域超高精密零部件与精密设备两大领域，引进高精度生产及检测设备，搭建超高精密产业化生产体系，实现产品从常规精度向超高精度的迭代升级。本项目建成后，公司将抢抓 CPO 技术产业化红利、扩充超高精密产品产能，助力公司卡位光通信高端核心赛道，构建差异化核心竞争优势，巩固在全球光通信精密制造领域的市场地位。

### （3）顺应半导体设备国产化趋势，加速构建核心配套能力

我国集成电路产业快速发展，下游晶圆制造、先进封装测试产线建设持续推进，对半导体设备及其核心精密零部件的国产化配套需求持续攀升。半导体设备零部件作为整机装备实现稳定运行的关键基础，是国内半导体产业链补短板、强链条的重要环节，行业整体市场规模保持高速增长，市场发展空间广阔。其中机械类结构件、工艺件等零部件品类市场需求旺盛，国产替代空间充足，为具备高端精密制造实力的本土企业带来广阔的增量发展机遇。

公司在半导体精密零部件与设备领域已形成较好的技术与客户基础。在半导体设备领域，公司已开发晶圆自动测试设备等产品，并实现小批量量产，相关技术获得国内头部半导体客户认可。面对半导体设备国产化提速的确定性趋势，公司需进一步提升核心零部件的自主配套能力。

本项目将建设专门面向半导体领域的高标准精密制造基地，提升公司在半导体精密零部件及半导体精密设备领域的产能规模与工艺水平，进一步增强公司对国内半导体设备客户的一体化配套能力。项目建设将助力公司深度参与半导体设备国产化进程，在国产供应链体系中占据更为重要的位置，共享国产替代带来的长期成长红利。

### 3、项目实施的可行性

#### (1) 平台型核心技术体系为项目切入新兴领域提供技术基础

公司自 2001 年成立以来，始终专注于非标自动化技术在先进制造领域的跨行业应用，是国内少数能够同时服务移动终端、新能源、硬盘、汽车智驾、医疗健康等多个行业的平台型自动化解决方案供应商。经过二十余年发展，公司构建了涵盖机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大技术领域的成熟研发体系，并形成了“高速、高精、高智、高效”四大共性技术平台，以及覆盖各下游行业产品特性的专用核心技术平台。这一平台型架构使得公司能够将不同行业积累的精密装配、在线检测、运动控制等成熟工艺快速复用至新兴领域，显著降低技术迁移成本和导入周期。

在半导体及光通信设备领域，公司已经成功将过去服务于移动终端摄像头模组检测、硬盘磁头装配等高精度场景的技术能力，平移至高精度贴装及对贴装配设备、芯片共晶贴片、光耦合设备等核心工序中，并获得海外头部客户的验证与认可。平台型技术架构不仅使公司具备快速响应新兴行业定制化需求的能力，也为本次募投项目涉及的半导体及光通信精密零部件与设备扩产提供了成熟的技术底座和工程化经验支撑，确保新增产能能够迅速转化为满足行业严苛要求的高品质产品。

#### (2) 超高精度加工能力为研发定制与量产交付提供双重保障

半导体及光通信器件的小型化、高集成度发展趋势，对精密零部件的加工精度和设备的系统级精度提出了持续升级的要求，微米乃至亚微米级的制造能力已成为行业竞争的关键壁垒。公司拥有行业领先的超高精度加工体系，配备高精度精密零部件加工设备 700 余台套，具备车、铣、磨、CNC、电火花、线切割等全工序加工能力，其中精密 CNC、线切割、电火花、镗磨、平面磨、光学磨等关键工种的加工精度可达 $\pm 1\mu\text{m}$  以内，零部件洁净度可达 RA0.02。在系统集成层面，公司自研的三轴高精平台已实现规模化量产，重复定位精度达 $\pm 50\text{nm}$ ，自研六轴平台最小步进精度小于 30nm，设备系统贴装精度控制在 $\pm 0.5\mu\text{m}$  以内，晶圆测

试温控范围在 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 以内，能够充分匹配半导体及光模块器件组装对精度和稳定性的严苛指标。

本项目所涉及的高精度耦合设备、晶圆测试设备及各类精密金属结构件，均对加工精度和装配一致性有较高要求。公司已有的超高精度加工能力和精密运动平台研发制造经验，能够为项目产品的研发定制阶段提供快速试制和迭代验证条件。在进入批量化生产阶段后，公司上述技术可保障产品良率与性能一致性，满足头部客户对供应链稳定性和交付质量的长期需求。

### （3）深度参与客户早期研发，绑定下一代技术路线以巩固竞争优势

公司长期坚持与各行业头部客户在新产品研发设计阶段即开展深度合作，在客户产品定义和工艺方案定型之前即介入预研，深入分析客户产品的生产工艺、技术参数及质量管控要点，共同确定自动化设备的功能架构与实现方案。这一模式使公司能够精准把握客户下一代产品对设备精度和工艺参数的升级需求，提前进行技术布局，从而在新一代产线设备采购周期中占据先发优势。在移动终端和新能源领域，公司已通过该模式与多家全球领先品牌建立了长期稳定的合作关系，成为其核心设备供应商。

在半导体及光通信领域，公司已成功为国内外多家头部客户提供覆盖光器件耦合、芯片贴装、AOI 芯片检测、光纤打磨等核心工序的工艺设备，并已获得海外头部客户的验证与认可。当前光模块正经历从 800G 向 1.6T 乃至 3.2T 的代际升级，工艺路线和精度要求持续演进，公司依托已有的早期参与机制和联合研发能力，能够在客户下一代产品量产前即锁定设备技术参数和供应份额。本次募投项目将充分运用这一先发合作模式，深度嵌入半导体及光通信行业头部企业的技术迭代路径，推动高精密自动化设备与零部件的同步升级，进一步巩固并扩大公司在行业内的市场份额与竞争壁垒。

## 4、项目投资概算

本项目投资总额为 69,729.39 万元，募集资金拟投入金额为 63,248.41 万元。

## **5、项目实施主体及实施地点**

本项目由科瑞技术及其全资子公司科瑞科技负责实施，实施地点为广东省深圳市。

## **6、项目经济效益**

本项目完全达产后，公司预计能实现年均销售收入 105,310.00 万元，年均净利润 11,879.62 万元，综合毛利率为 31.80%，净利率为 11.28%。本项目税后内部收益率为 13.75%，税后静态投资回收期为 8.08 年。

### **（二）补充流动资金**

#### **1、项目基本情况**

根据公司经营发展规划，公司拟使用募集资金 12,000.00 万元用于补充流动资金，有助于缓解公司快速发展过程中对资金的需求压力，保证公司可持续发展。

#### **2、项目实施的必要性和合理性分析**

##### **（1）提供营运资金支持，抓住快速发展机遇**

未来随着公司业务规模与营收规模的提升，应收账款及存货等经营性流动资产规模也将同步扩大，对流动资金形成一定占用。因此，公司通过本次发行募集资金部分用于补充流动资金，有利于保障公司在业务规模扩大过程中的日常营运资金需求，帮助公司快速抓住行业发展机遇，提升公司市场竞争力。

##### **（2）优化公司财务结构，增强公司抗风险能力**

本次发行募集资金部分用于补充流动资金，有助于公司优化财务结构，增强公司资本实力，从而降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司持续、稳定、健康发展。

### **三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响**

#### **（一）本次发行对公司经营管理的影响**

本次向特定对象发行股票的募集资金投资的项目围绕公司主营业务开展，系对公司主营业务的拓展和完善。募集资金投资项目的实施将在公司主营业务保持稳定的基础上，丰富并优化公司业务结构，将对公司经营业务产生积极影响。本次募集资金投资项目的实施将对公司的主营业务产生积极的影响，有利于公司的可持续发展，符合公司的长远发展目标和全体股东的根本利益。

#### **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次向特定对象发行股票完成后，公司的总资产规模和净资产均将相应增加；同时公司资产负债率将相应下降，公司的资产结构将进一步优化；还有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险，提高公司的资信水平和抵御风险的能力，为公司后续发展提供良好保障。

### **四、募集资金投资项目可行性分析结论**

综上所述，本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力。本次募集资金使用用途符合相关政策和法律法规，符合公司及全体股东的利益，具备必要性和可行性。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日